



## 三菱ガス化学株式会社

平成20年5月7日

### 銅張積層板製造設備等の稼働について

三菱ガス化学株式会社（本社：東京都千代田区、社長：酒井和夫、以下「MGC」という）は、生産子会社エレクトロテクノ株式会社（福島県西白河郡、以下「エレクトロテクノ」という）において銅張積層板およびプリプレグの生産能力増強を進めておりましたが、本年4月に量産体制が整いました。新設備の生産能力は月産30万㎡で、エレクトロテクノの生産能力は既存の設備も含め、月産100万㎡となりました。また、今回の能力増強では、市場でのニーズが高まっている、より薄い材料の生産にも対応できる最新鋭設備を導入しています。

MGCでは、短期的な需要の成長と調整を繰り返しながら拡大を続ける半導体市場に対応して、銅張積層板を安定的に供給してまいります。

#### 【MGCの電子材料事業について】

MGCは半導体基板材料として高いシェアを持つBT樹脂銅張積層板、高多層基板に使われる高性能エポキシ樹脂銅張積層板、プリント配線板の小孔加工時に使用する補助材「LEシート」を中心に製造販売しております。

主力製品のBT樹脂銅張積層板は、MGCが独自に開発したBT樹脂の優れた耐熱性、高周波特性が高く評価され、BGA、CSP、SIP、LED、ICカードなどの半導体パッケージ材料やモジュール基板材料として幅広く使用されており、今後もデジタル関連機器の伸張に合わせた需要の増加が見込まれております。

また、MGCの高性能エポキシ樹脂銅張積層板は、高速化・低伝送損失化などに対応できる電気特性、高耐熱性が求められる通信インフラ機器、情報機器、半導体試験装置等への採用が広がっております。

#### 【エレクトロテクノ概要】

エレクトロテクノは銅張積層板の製造を行う、MGCの100%子会社です。生産能力は月産100万㎡（2008年4月現在）。なお、銅張積層板の販売はMGCが行っております。



## 三菱ガス化学株式会社

### <用語説明>

プリプレグ：ガラス繊維布などの基材に熱硬化性樹脂を含浸させたシート。

銅張積層板：任意の枚数を重ねたプリプレグの片面、または両面に銅箔を載せ、加熱・加圧加工し、一体化させたもの。

半導体パッケージ：半導体が直接搭載されたプリント基板。

モジュール基板：複数の半導体あるいは電子部品を搭載したプリント基板。

### <本件に関するお問い合わせ先>

三菱ガス化学株式会社 広報 IR 部 奥石

TEL：03-3283-5041